

胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于三级全资子公司之间提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足业务发展需要，胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）三级全资子公司湖南维胜科技有限公司（以下简称“维胜科技”）向交通银行股份有限公司湖南省分行（以下简称“交通银行湖南省分行”）申请人民币 8000 万元的授信额度，公司三级全资子公司湖南维胜科技电路板有限公司（以下简称“维胜电路板”）为维胜科技申请银行授信提供连带责任保证担保。

上述担保事项已经维胜电路板董事会及股东会审议通过。

二、被担保人基本情况

- 公司名称：湖南维胜科技有限公司
- 成立时间：2003 年 9 月 12 日
- 住址：长沙经济技术开发区东二路 10 号
- 法定代表人：RONNIE CHIN
- 注册资本：5,000,000 美元
- 经营范围：生产挠性电路板及挠性板的装配以及与此相关的组装类电子产品及上述产品自销。
- 股权结构：公司通过 Pole Star Limited 持有 MFS Technology (S) Pte Ltd 100% 股权，MFS Technology (S) Pte Ltd 持有湖南维胜科技有限公司 100% 股权。
- 主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，湖南维胜科技有限公司经审计的资产总额为 56,092.00 万元，负债总额为 42,679.77 万元；2023 年营业收入为 94,174.56 万元，净利润 5,923.86 万元。

维胜科技不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

维胜科技电路板与交通银行湖南省分行签订的《保证合同》的主要内容：

保证人：湖南维胜科技电路板有限公司

债务人：湖南维胜科技有限公司

债权人：交通银行股份有限公司湖南省分行

担保金额：1 亿元人民币

保证方式：连带责任保证

保证范围：保证人担保的主债权为 2024 年 7 月 15 日至 2029 年 7 月 15 日期间签订的全部主合同项下的全部主债权，包括债权人根据主合同向债务人发放的各类贷款、透支款、贴现款和/或各类贸易融资款(包括但不限于进口押汇、进口代收融资、进口汇出款融资、出口押汇、出口托收融资、出口发票融资、出口订单融资、打包贷款、国内信用证押汇、国内信用证议付，国内保理融资、进出口保理融资等)，和/或者，债权人因已开立银行承兑汇票、信用证或担保函(包括备用信用证，下同)而对债务人享有的债权(包括或有债权)，以及债权人因其他银行授信业务而对债务人享有的债权(包括或有债权)。

保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计实际担保金额为人民币 1 亿元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 1.31%，均系公司全资子公司之间的担保。公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日